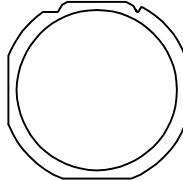
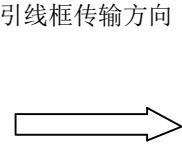
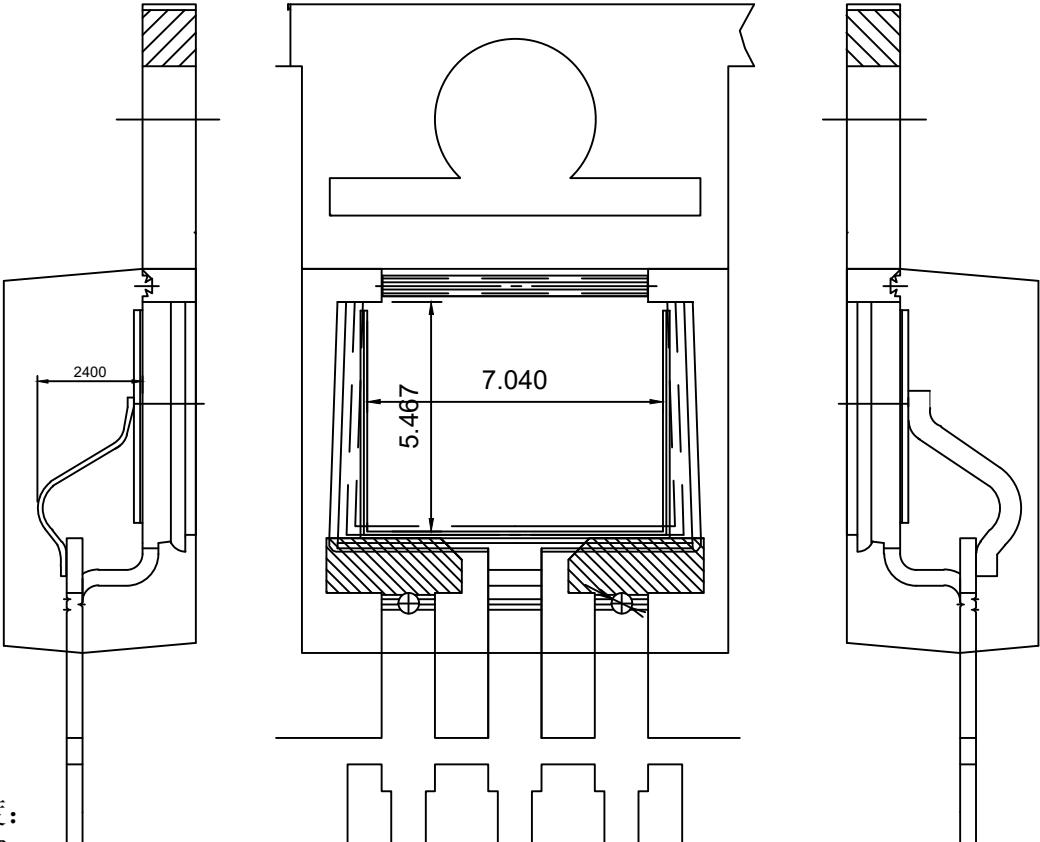




## 装片键合配线图

配线图号	版本号	封装外形	TO-263-3L	
装片方向 		客户回答		
引线框传输方向 				
				
*特殊要求 线弧高度: AL Ribbon CU Wire $\leq 600\mu\text{m}$ 图纸坐标A, 坐标B公差 $\pm 50\mu\text{m}$				
芯片信息		封装信息		
成品名称			装片方式	
芯片名称			框架型号	
芯片尺寸 (um)		芯片厚度 (um)		S极焊线
G极尺寸 (um)		晶圆正面金属	基岛尺寸 (mm) 7.04 * 5.47	总线数
切割道尺寸 ( $\mu\text{m}$ )		晶圆背金	电镀方式 雾锡	制图日期
线图来源			备注	
拟制	审核		批准	文控发行章